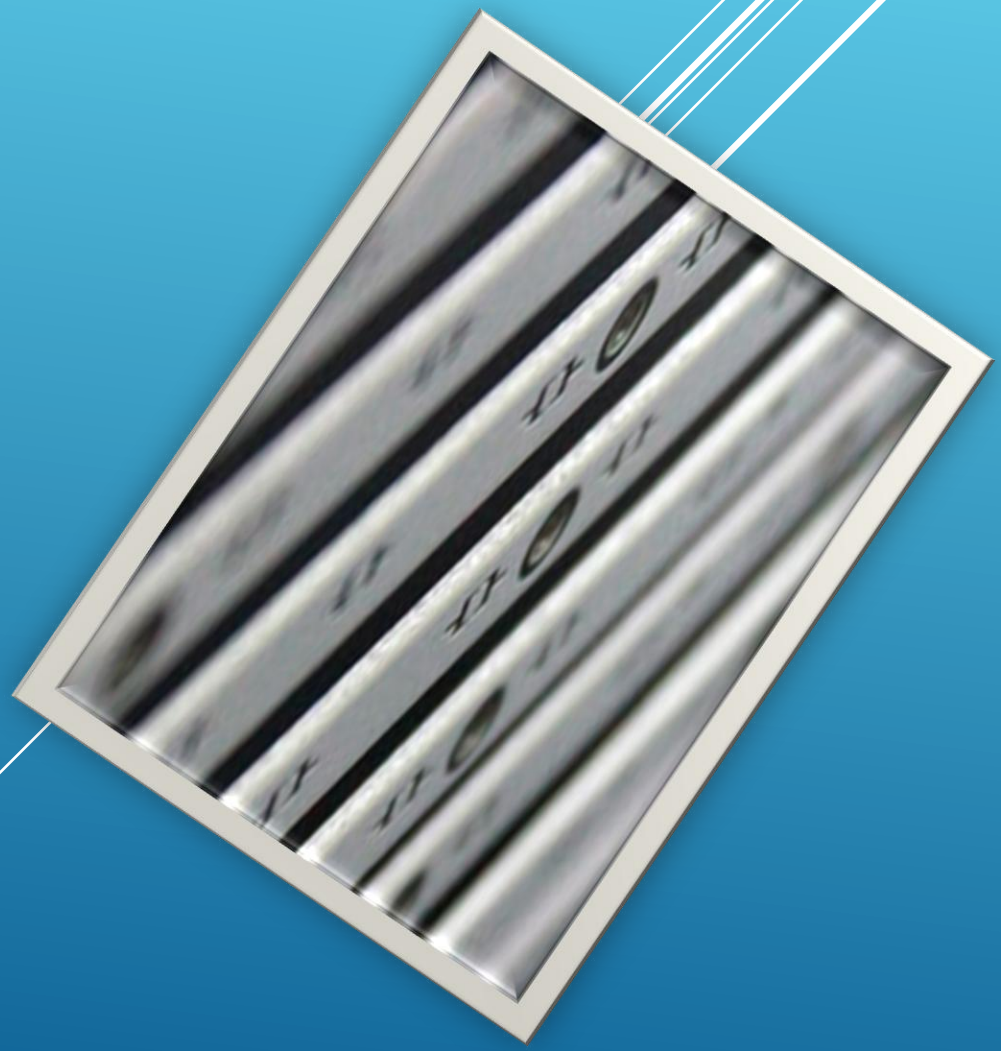
GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD (Taiwan Factory)
GIA TZOONG LTD. (shenzhen)

佳總興業股份有限公司

法人說明會

2026



- **議程**
- 一、 概況
- 二、 財務報表
- 三、研發狀況
- 四、營運展望
- 五、問與答

一、概況

- 設立日期：民國77年9月19日。
- 上櫃日期：民國87年6月23日。
- 資本額：新台幣7.75億元。
- 員工人數：271人
- 主要營業項目：印刷電路板
- 公司總部：台灣桃園

二、財務狀況

(一) 損益表

單位：NTD千元

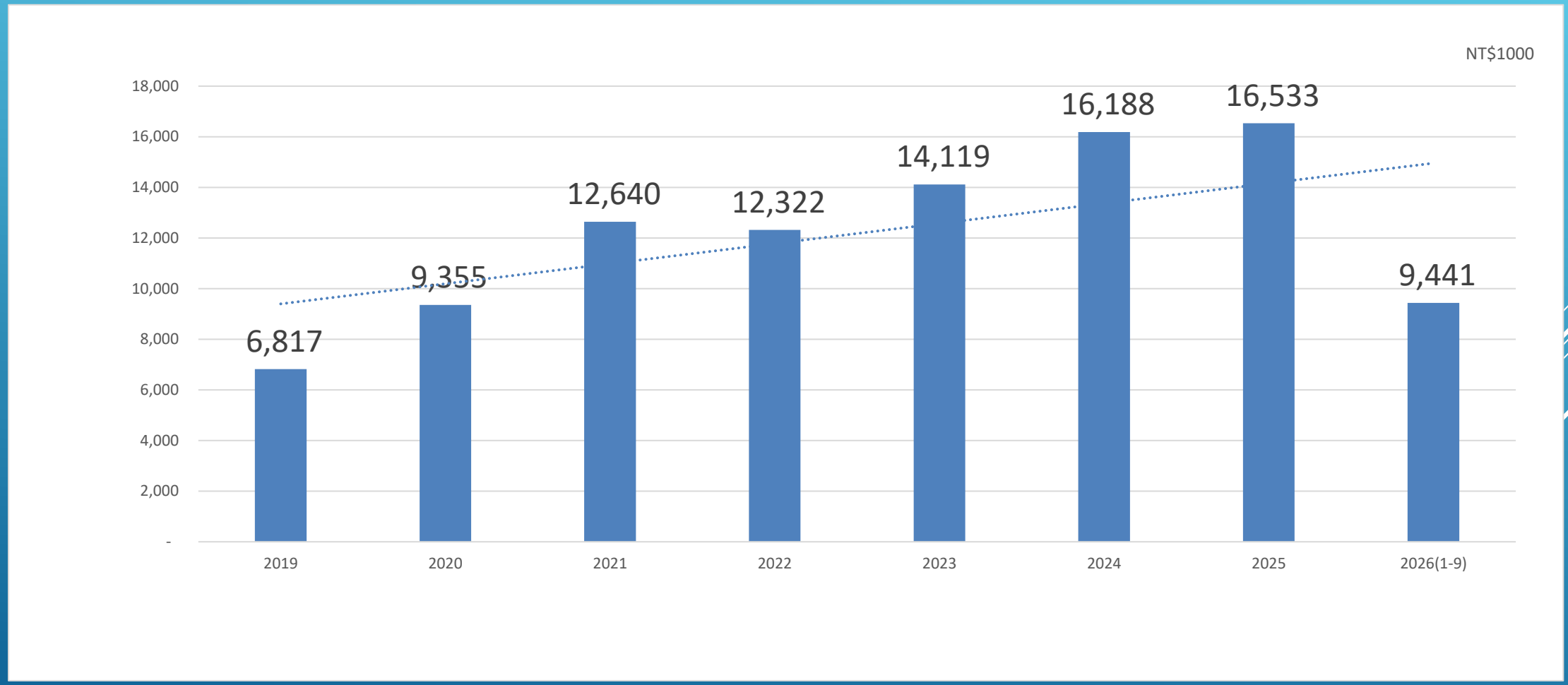
項　　目	2026/1-9	2025/1-9	差異率%
營業收入	499,034	341,511	46
營業成本	(472,044)	(407,400)	16
營業毛利(損)	26,990	(65,889)	(141)
營業費用	(72,003)	(64,767)	11
營業利益(淨損)	(45,013)	(130,656)	(66)
營業外收支	18,421	(6,736)	(373)
稅前損益	(26,592)	(137,392)	(81)
所得稅利益(費用)	1,100	1,442	(24)
本期淨利(損)	(25,492)	(135,950)	(81)

(二)佳總前三季損益表

單位：NTD千元

115(2026)年	第一季	第二季	第三季
營業收入	118,960	167,633	212,441
營業成本	(130,842)	(154,537)	(186,665)
營業毛利(損)	(11,882)	13,096	25,776
營業費用	(24,408)	(22,763)	(24,832)
營業利益(淨損)	(36,290)	(9,667)	944
營業外收支	14,628	4,779	(986)
稅前淨利	(21,662)	(4,888)	(42)
所得稅利益(費用)	(2,071)	(588)	3,759
本期淨利(損)	(23,733)	(5,476)	3,717

三、研發狀況


NT$1000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-
6,817
9,355
12,640
12,322
14,119
16,188
16,533
9,441
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026(1-9)

佳總研發技術發展以提升高階PCB製程能力及特殊應用產品開發為主軸，分階段進行技術深化與產品應用拓展。

技術發展方向	近期發展重點	中長期發展方向
HDI／高階多層板	高層數、微孔及細線路製程能力提升	20層以上高層數PCB製程深化、AnyLayer結構及多階微孔製程開發、層間對位精度提升
高速材料PCB	低損耗高速材料評估及異質材料混壓製程驗證	M8以上高速材料應用評估、PTFE與FR-4異質材料混壓技術開發、高頻高速傳輸PCB應用
MCPCB／陶瓷基板	高散熱結構設計及陶瓷與金屬接合技術開發	AMB／DBC陶瓷基板接合技術深化、高功率模組散熱基板及高可靠度金屬陶瓷複合結構開發
內埋式電路板（CIB）	內埋結構設計、製程整合及可靠度驗證	LED光源模組、功率模組、RF陣列天線及光通訊模組之內埋式電路板產品開發

四、營運展望

- (一)DBC 、 AMB
  - (1) 潛力客戶數：11
  - (2) 合作開發中客戶數：4
  - (3) 量產客戶數：2
- (二)FR4：新型態-內埋(內埋陶瓷及電子元件)
  - (1)潛力客戶數：8
  - (2)合作開發中客戶數：8
  - (3)量產中客戶數：1

Q&A

謝謝您的參與